



RELATÓRIO DE NPI

FR455

REFERÊNCIAS BÁSICAS

CÓD. PRODUTO ACABADO: 6248

DESCRIÇÃO: 2486

Nº OP: 2684

CLIENTE: SSAT SINALIZACAO E ADESIVOS EIRELI

QTDE TOTAL OP: 2648

QTDE NPI: 2648

DATA: 01/02/2023

APRESENTAÇÃO DO NPI

Aplicação do Produto: Automacao Comercial

Classe (IPC-A-610):

Documentação está Ok : SIM

Falta o documento de:

Item possui revisão anterior: NÃO

Qual cód.?

Origem do Stencil? Origem 1 (Serdia)

Data de chegada: 2023-02-08

Etiquetas do cliente? SIM

Quant. Etiquetas: 12

Tipo de Liga: Lead free

Instr. de Montagem Especial? SIM

Os componentes possuem especificações quanto à altura, clinche ou ângulo?

☐

Todos os cabos contêm suas especificações?

☐

Existem especificações e desenhos de montagem do produto?

☐

Existem especificações e desenhos de montagem do produto?

☐

☐ Embalagem é pertencente ao Cliente?

Etapas produtivas:

☐ SMT Bottom

☐ Mont. PTH

☐ Teste

☐ OBA

☐ SMT Top

☒ Mont. Lean

☐ ICT

☐ Certificado de Qualidade

☐ AOI

☐ Verniz

☐ Gravação

☐ Registro de Histórico do Produto

☐ Outros

☐ Produtos Químicos (NOVO)

Ações de melhoria:

☒ desenvolver gabarito

☐ recolher documentação

☐ painelizar PCI

☐ Solicitar teste (doc, jiga licença p/ Sist. Operacional...)

Comentários quanto a apresentação do novo produto:

REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO

Organizador (Eng. de Produto): Ana Paula Jahnz

Data: 2023-01-18

Participantes:

Eng. de Processo PTH:

Eng. de Teste:

Eng. de Processo SMT:

Comercial:

Eng. da Qualidade:

Outros:

REALIZAÇÃO DO NPI

ALMOXARIFADO

Responsável : Wajdi Ben Helal

Data: 2023-01-18

Atividade: Separação de materiais no almoxarifado

☒ Foi identificadodd alguma divergência de materiais?

☒ Algum componente será montado sob desvio?

Comentários quanto a apresentação do novo produto:
dxqz

MONTAGEM SMT

Run10 nº.:

EXECUÇÃO DA MONTAGEM SMT

Responsável : Sirlene Steclan

Data: 2023-02-01

Atividade: Printer

Stencil: identificado algum problema ou oportunidade de melhoria?

☐

Tipo de insumo aplicado? TINLEAD

Tipo de apoio utilizado na Printer? BARRAS

Inspeção por SPI?

☐

Serigrafia: identificado algum problema ou oportunidade de melhoria?

☐

Atividade: Inserção automática

Em qual linha foi realizado o NPI? LINHA 3

Inserção do Bottom: algum problema ou oportunidade de melhoria?

☐

Inserção do Top: algum problema ou oportunidade de melhoria?

☐

Atividade: Reflow e Inspeção

Perfil: foi utilizado o perfil "padrão"?

☒

Se NÃO, informar nome do perfil utilizado:

Realizado inspeção visual?

☒

Utilizado Raio-X? *

☐

Atividade: Router

Utilizado base dedicada ou pinos de apoio durante NPI? PINOS

Identificado algum problema ou oportunidade de melhoria?

☒

VERIFICAÇÃO DA MONTAGEM SMT (RUN10)

Responsável : Wajdi Ben Helal

Data: 2023-01-18

VERIFICAÇÃO PARCIAL - MONTAGEM SMT

Seq. de Placas (número de série)

OK/FALHA

Descrição da Falha

Placa 1 : 123651111

Ok

C123 - coplanar

Comentários técnicos e Análise crítica referente a Montagem SMT: Montagem ocorreu sem problemas.

Houve problemas críticos? Não

Gerado documento devido a problemas? Não

Verificação da Montagem SMT APROVADO

Validado por: Sirlene Steclan

Junto com: CRISTIAN AUGUSTO DE MACEDO E LIMA

MONTAGEM THT/LEAN

Run10 nº.:

EXECUÇÃO DA MONTAGEM THT/LEAN

Responsável: Willian Costa

Data: 2023-02-01

Atividade: Pré forma

Foi identificada alguma dificuldade de pré formatação?

☒

Necessário desenvolvimento de gabaritos ou ferramentas para as operações?

☐

Atividade: Cablagem

As especificações e desenhos podem gerar dúvidas no operador?

☐

Existem pontos que podem ser modificados para melhorar o processo?

☐

Necessário desenvolvimento de gabaritos ou ferramentas para as operações?

☐

Atividade: Pré compor

Houve alguma dificuldade na depainelização?

☐

Existem pontos que podem ser modificados para melhorar o processo?

☐

Necessário desenvolvimento de gabaritos ou ferramentas para as operações?

☐

Atividade: Compor

Foi identificado algum problema durante a montagem?

☐

Se foi utilizado pallet seletivo, ele atendeu ao processo?

☐

Necessário desenvolvimento de gabaritos ou ferramentas para as operações?

☐

Atividade: Soldar PTH/Inspeção

Foi identificado algum problema durante a operação de montagem?

☐

A atividade de Touch up será necessário?

☒

O layout da placa facilita a operação de ressolda?

☒

Necessário desenvolvimento de gabaritos ou ferramentas para as operações?

☐

Atividade: Montagem Mecânica/Montagem Final

Todos os componentes contêm suas especificações?

☐

As especificações e desenhos podem gerar dúvidas no operador?

☐

Existem pontos que podem ser modificados para melhorar o processo?

☐

Existe a aplicação de verniz no produto?

☐

Necessário desenvolvimento de gabaritos ou ferramentas para as operações?

☐

VERIFICAÇÃO DA MONTAGEM THT/Lean (RUN10)

Responsável: Willian Costa

Data:

VERIFICAÇÃO PARCIAL - MONTAGEM THT/LEAN

Seq. de Placas (número de série)

OK/FALHA

Descrição da Falha

Placa 1 : 123651111

Ok

JP1 - sem solda

Comentários técnicos e Análise crítica referente a Montagem THT/Lean: xdqzx

Houve problemas críticos?

Gerado documento devido a problemas? ☒

Doc.:

APROVADO

Validado por: CARMEM MONTOIA

Junto com: Daniele Araujo

TESTES

Run10 nº.:

EXECUÇÃO DO TESTE

Responsável: Willian Costa

Data:

EXECUÇÃO DO TESTE

Qual tipo de teste é realizado?

Testes/Jiga desenvolvido por?

- ☐ Cliente acompanhou o processo de implementação dos testes?
- ☐ Identificado algum problema ou oportunidade de melhoria?
- ☐ Jiga e/ou dispositivos de Testes podem causar algum “choque mecânico”?
- ☐ Necessário desenvolvimento de gabaritos ou ferramentas para as operações?

RESULTADOS DO TESTE

Responsável : Willian Costa

Data: 2023-02-03

VERIFICAÇÃO DOS RESULTADOS DO TESTE

Seq. de Placas (número de série)

OK/FALHA

Descrição da Falha

Placa 1 : 123651111

Ok

não liga

Comentários técnicos e Análise crítica referente ao Testes: xdzq

EMBALAGEM

Run10 nº.:

Responsável : Willian Costa

Data: 2023-02-01

Atividade: Embalagem

☐ Há necessidade de etiqueta ESD?

☒ Comentários técnicos referente a etapa de Embalagem:

Qual tipo de embalagem será utilizado?
PLÁSTICO BOLHA

Como a embalagem será fechada? FITA
ANTIESTÁTICO

REUNIÃO DE FECHAMENTO (report de mudanças e validação final)

Organizador (Eng. da Qualidade) : Rafael Przybysz

Data: 2023-02-03

Participantes:

Eng. de Processo PTH: Celina Maximo Anna Paulla da Rocha	Eng. de Teste: Alessandra Gomes ADRIANA FERREIRA Marcelo Daniel Camargo Dos Santos DOUGLAS HENRIQUE CRUZ
Eng. de Processo SMT: João Ramiro Diogo Pereira	PCPM: Alessandra Gomes Ageu Reis de Paiva Ana Carla Mendes
Eng. de Produto: Rafael Przybysz Ana Paula Jahnz	Outros: Alessandra Gomes Cristiane Santos

ANÁLISE CRÍTICA:

Responsável Eng. de Processo: (autorização de mudanças) Adriana F. de Lima Jeremias

PARECER FINAL STATUS

APROVADO

Com restrições? SIM	Implementação de: dxzq
Novo Run10 é possível? *outra tentativa imediata para nova análise crítica SIM	Responsável Eng. da Qualidade: (parecer final) (autorização de mudanças) Sirlene Steclan